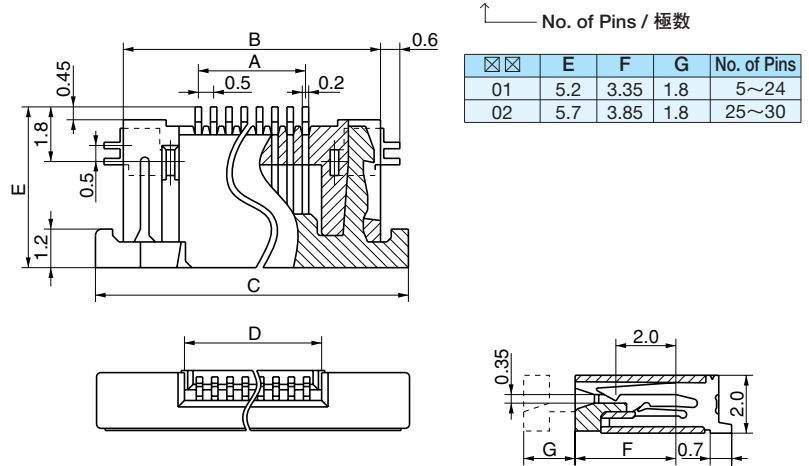


FP-50 Series 0.5mm Pitch (SMT)



● Upper Contact Type CFP55□□-☒☒50F



■ Features

1. Our structure to hold the FPC temporary, provides easy operability.
2. Positive clicking feeling ensure the insertion.
3. Either upper or lower contact location available.
4. Low profile of 2mm height when mounted.
5. Using the ZIF structure.
6. Supplied in the embossed taping with automatic mounter.

■ Specifications

1. Rating : 0.5A, 50V AC/DC
2. Contact Resistance : 30mΩ max., initially
3. Insulation Resistance : 100MΩ min. at 100V DC
4. Withstanding Voltage : 100V AC (for one minute)
5. Operating Temperature Range : -40°C to +85°C

■ Material and Plating

- Housing : Thermoplastic Resin, Natural Color, 94V-0
- Cover : Thermoplastic Resin, Natural Color, 94V-0
- Contact : Cu Alloy, Au Plating
- Hold Down : Cu Alloy, Sn Plating

■ 特 長

1. FPC仮保持機能により、操作性を高めています。
2. FPC挿入時にクリック感があり、不完全挿入を防止します。
3. 接触部の位置は、上側と下側タイプがあります。
4. 実装高さは2mmです。
5. ZIF構造を採用しています。
6. 自動マウンタ対応でエンボステープ方式による供給です。

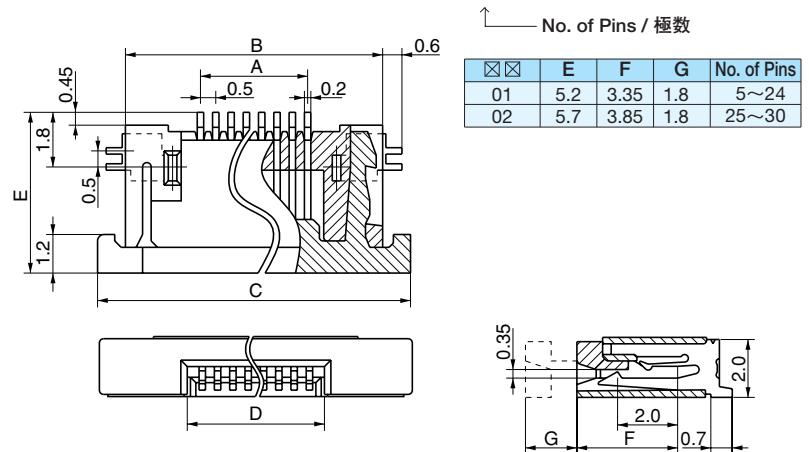
■ 仕 様

1. 定格電圧電流 : AC/DC 50V 0.5A
2. 接 触 抵 抗 : 初期30mΩ以下
3. 絶 縁 抵 抗 : DC 100V 100MΩ以上
4. 耐 電 圧 : AC 100V (1分間)
5. 使用温度範囲 : -40°C ~ +85°C

■ 材質・表面処理

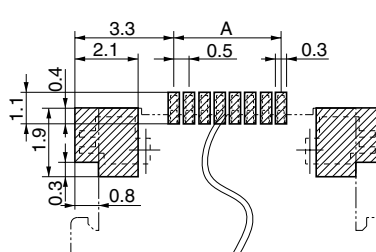
- ハウジング : 熱可塑性樹脂 原色 94V-0
- カバ ー : 熱可塑性樹脂 原色 94V-0
- コンタクト : 銅合金 金めっき
- ホールダウン : 銅合金 すずめっき

● Lower Contact Type CFP57□□-☒☒50F



□□	A	B	C	D	□□	A	B	C	D
05	2.0	7.0	8.8	3.1	18	8.5	13.5	15.3	9.6
06	2.5	7.5	9.3	3.6	19	9.0	14.0	15.8	10.1
07	3.0	8.0	9.8	4.1	20	9.5	14.5	16.3	10.6
08	3.5	8.5	10.3	4.6	21	10.0	15.0	16.8	11.1
09	4.0	9.0	10.8	5.1	22	10.5	15.5	17.3	11.6
10	4.5	9.5	11.3	5.6	23	11.0	16.0	17.8	12.1
11	5.0	10.0	11.8	6.1	24	11.5	16.5	18.3	12.6
12	5.5	10.5	12.3	6.6	25	12.0	17.0	18.8	13.1
13	6.0	11.0	12.8	7.1	26	12.5	17.5	19.3	13.6
14	6.5	11.5	13.3	7.6	27	13.0	18.0	19.8	14.1
15	7.0	12.0	13.8	8.1	28	13.5	18.5	20.3	14.6
16	7.5	12.5	14.3	8.6	29	14.0	19.0	20.8	15.1
17	8.0	13.0	14.8	9.1	30	14.5	19.5	21.3	15.6

■ P.C. Board Dimension 取付基板参考図



■ Applicable FPC Dimension 適合FPC参考寸法 (t=0.3±0.05)

